

Title (en)

Method for ceramic wave foot grinding.

Title (de)

Verfahren zum Schleifen der Standflächen keramischer Artikel.

Title (fr)

Méthode pour le meulage des surfaces de support d'articles en céramique.

Publication

**EP 0488143 A1 19920603 (DE)**

Application

**EP 91120146 A 19911126**

Priority

DE 4038031 A 19901129

Abstract (en)

In the case of large round, oval or cornered objects, it is necessary for stability reasons during fire to create a further supporting point in the centre of the underside of the article in addition to the normal article foot. For this reason, a wave foot which can have the form of a web is integrally formed. Articles with this base configuration were hitherto ground by hand in a break-off machine. In contrast, the invention provides for the articles to be ground automatically by the articles, shown as oval plates 12, being placed with the corresponding work holders 14 on a rotary table 18 with six stations I, II, III, IV, V and VI. In station II, the wave foot 16 is ground with a grinding belt; and the plate foot 17 is ground in stations III, IV and V. For this purpose, the plates 12 or their work holders rotate eccentrically to the grinding tool at least in station II. <IMAGE>

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Schleifen der Standflächen keramischer Artikel. Bei großen runden, ovalen oder eckigen Gegenständen ist es aus Stabilitätsgründen während des Brands notwendig, zusätzlich zum normalen Artikelfuß einen weiteren Abstützpunkt im Zentrum der Artikelunterseite zu schaffen. Aus diesem Grund wird ein Konterfuß, der die Form eines Steges haben kann, angeformt. Artikel mit dieser Bodengestaltung wurden bisher von Hand auf einer Abrißmaschine geschliffen. Die Erfindung sieht dagegen vor, die Artikel automatisch zu schleifen, in dem die Artikel, dargestellt als ovale Platten 12, auf einem Drehtisch 18 mit sechs Stationen I, II, III, IV, V und VI mit den entsprechenden Werkstückhaltern 14 aufgelegt werden. In der Station II erfolgt der Schliff des Konterfußes 16 mit einem Schleifband; in den Stationen III, IV und V der Schliff des Plattenfußes 17. Dazu rotieren die Platten 12 bzw. deren Werkstückhalter mindestens in der Station II exzentrisch zum Schleifwerkzeug. <IMAGE>

IPC 1-7

**B24B 1/04**; **B24B 19/00**; **B24B 21/22**

IPC 8 full level

**B24B 1/04** (2006.01); **B24B 19/00** (2006.01); **B24B 21/22** (2006.01); **B24B 27/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B24B 1/04** (2013.01); **B24B 19/008** (2013.01); **B24B 21/22** (2013.01); **B24B 27/0023** (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] US 2741076 A 19560410 - JACOB JORDAN
- [A] US 4939870 A 19900710 - WANG TIEN-WANG [TW]
- [Y] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 235 (M-415)(1958) 21. September 1985 & JP-A-60 090 668 ( SUWA SEIKOSHA ) 21. Mai 1985

Cited by

CN103522155A; CN116604425A; EP2551053A1; CN109822429A; EP0678358A1; EP0662365A1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0488143 A1 19920603**; **EP 0488143 B1 19950412**; DE 4038031 A1 19920604; DE 4038031 C2 19921112; DE 59105170 D1 19950518

DOCDB simple family (application)

**EP 91120146 A 19911126**; DE 4038031 A 19901129; DE 59105170 T 19911126